

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第7部門第2区分
 【発行日】令和7年6月17日(2025.6.17)

【国際公開番号】WO2024/075816
 【出願番号】特願2024-555858(P2024-555858)

【国際特許分類】

H 0 1 L 2 3 / 0 2 (2 0 0 6 . 0 1)

H 0 1 L 2 3 / 0 4 (2 0 0 6 . 0 1)

H 0 1 L 2 3 / 1 2 (2 0 0 6 . 0 1)

H 0 5 K 1 / 0 2 (2 0 0 6 . 0 1)

10

【 F I 】

H 0 1 L 2 3 / 0 2 H

H 0 1 L 2 3 / 0 2 F

H 0 1 L 2 3 / 0 4 E

H 0 1 L 2 3 / 1 2 3 0 1

H 0 5 K 1 / 0 2 J

【手続補正書】

【提出日】令和7年4月2日(2025.4.2)

20

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1上面と、該第1上面と反対側の第1下面と、前記第1上面および前記第1下面と接続する第1側面と、前記第1上面に開口を有する第1開口部と、を有し、金属材料で構成される基部と、

30

第2上面と、該第2上面と反対側の第2下面と、前記第2上面および前記第2下面と接続し前記第1側面に沿って位置する第2側面と、を有し、前記第1上面に位置する誘電体基板と、

前記第2側面から遠ざかる第1方向に延びる第1線路部と、前記第1線路部と前記第2側面との間に位置する第1接続部と、を有し、前記第2上面に位置する第1信号導体と、を備え、

前記第1側面に沿う第2方向における前記第1接続部の最大の寸法は、前記第2方向における前記第1線路部の最大の寸法よりも大きく、

平面視において、前記第1開口部は、前記第1接続部の少なくとも一部と重なって位置している、配線基板。

40

【請求項2】

前記第2下面に位置し、第1開口領域を有する下面接地導体を更に備え、

平面視において、前記第1開口領域は、前記第1開口部内に位置するとともに、前記第1接続部と重なって位置している、請求項1に記載の配線基板。

【請求項3】

前記第1開口部は、前記第1側面と交差して位置している、請求項1に記載の配線基板。

【請求項4】

前記第1側面に沿う第2方向における前記第1開口部の最大の寸法は、前記第2方向における前記第1接続部の最大の寸法以上である、請求項1に記載の配線基板。

50

【請求項 5】

前記誘電体基板は、第 1 内壁面を含む第 1 凹部を更に有し、
前記第 1 凹部は、前記第 2 上面および前記第 2 側面と交差するとともに、平面視において前記第 1 開口部と重なって位置し、
前記第 1 内壁面は、前記第 2 上面および前記第 2 側面と連続し、
前記第 1 信号導体は、前記第 1 内壁面にまで延びて位置し、
平面視において、前記第 2 側面に沿う第 2 方向における前記第 1 凹部の最大の寸法は、前記第 2 方向における前記第 1 接続部の最大の寸法よりも小さい、請求項 1 に記載の配線基板。

【請求項 6】

平面視において、前記第 1 方向における前記第 1 側面から前記第 1 開口部の内縁までの最大の距離は、前記第 1 方向における前記第 1 凹部の最大の寸法よりも大きい、請求項 5 に記載の配線基板。

【請求項 7】

前記第 2 上面において、前記第 1 信号導体と間を空けて位置する上面接地導体と、
前記誘電体基板内に位置する内層接地導体と、を更に備え、
前記第 1 接続部は、前記第 2 側面側に位置する第 1 端部を有し、
前記上面接地導体は、前記第 2 側面側に位置する第 2 端部を有し、
前記内層接地導体は、前記第 2 側面側に位置する第 3 端部を有し、
側面視において、前記第 2 方向における前記第 1 端部と前記第 2 端部との最小の距離は、前記第 2 方向における前記第 1 端部と前記第 3 端部との最小の距離よりも大きい、請求項 1 に記載の配線基板。

【請求項 8】

前記第 1 接続部は、前記第 2 上面において、前記第 2 側面に沿うとともに前記第 2 方向に突出する突出部を有している、請求項 5 に記載の配線基板。

【請求項 9】

平面視において、前記第 1 信号導体と重なる第 1 先端部を有するとともに、前記第 1 接続部に電氣的に接続される、第 1 接続部材を更に備え、
平面視において、前記第 1 先端部は、前記第 1 開口部内に位置する、請求項 1 に記載の配線基板。

【請求項 10】

前記第 2 方向における前記第 1 接続部材の最大の寸法は、前記第 2 方向における前記第 1 開口部の最大の寸法よりも小さい、請求項 9 に記載の配線基板。

【請求項 11】

前記第 1 方向における前記第 1 側面から前記第 1 開口部の内縁までの最大の距離は、前記第 1 方向における前記第 1 側面から前記第 1 先端部までの最大の寸法より大きい、請求項 9 に記載の配線基板。

【請求項 12】

平面視において、前記第 1 接続部に電氣的に接続される、第 1 接続部材を更に備え、
平面視において、前記第 1 接続部材の少なくとも一部は、前記第 1 凹部と重なって位置している、請求項 5 に記載の配線基板。

【請求項 13】

前記誘電体基板は、前記第 2 下面に開口を有する第 2 凹部を更に有し、
平面視において、前記第 2 凹部は、前記第 1 信号導体の少なくとも一部と重なって位置している、請求項 1 ~ 12 のいずれか 1 つに記載の配線基板。

【請求項 14】

平面視において、前記第 2 凹部は、前記第 1 開口部の少なくとも一部と重なって位置しており、
平面視において、前記第 1 方向における前記第 2 凹部の最大の寸法は、前記第 1 方向における前記第 1 開口部の最大の距離以下である、請求項 13 に記載の配線基板。

10

20

30

40

50

【請求項 15】

前記誘電体基板は、前記第2下面に開口を有する第2凹部を更に有し、
平面視において、前記第2凹部は、前記第1信号導体の少なくとも一部と重なって位置し、
平面視において、前記第1方向における前記第2凹部の最大の寸法は、前記第1方向における前記第1凹部の最大の寸法よりも大きい、請求項5に記載の配線基板。

【請求項 16】

前記基部上および/又は前記誘電体基板上に接合された枠体と、
前記枠体に固定された請求項1～12のいずれか1つに記載の配線基板と、を備えている、電子部品実装用パッケージ。

10

【請求項 17】

請求項16に記載の電子部品実装用パッケージと、
前記基部上又は前記誘電体基板上に位置し、前記配線基板と電氣的に接続された電子部品と、
前記枠体上に位置し、前記電子部品実装用パッケージの内部を覆って位置する蓋体と、
を備えている、電子モジュール。

20

30

40

50